

Matériaux de base pour circuits imprimés

Base materials for printed circuits

Partie 2: Spécifications
Spécification n° 17: Feuille de stratifié mince
en tissu de verre polyimide couverte de cuivre,
d'inflammabilité définie, destinée à la fabrication
des cartes imprimées multicouches

Part 2: Specifications
Specification No. 17: Thin polyimide woven glass
fabric copper-clad laminated sheet of defined
flammability for use in the fabrication of
multilayer printed boards

C O R R I G E N D U M 1

Page 10

Paragraphe 5, tableau 1

Au lieu de:

Résistivité transversale après chaleur humide, mesure effectuée dans la chambre climatique (facultatif)	2.3	10 000 M Ω · min.
Résistivité transversale après chaleur humide et reprise	2.3	50 000 M Ω · min.
Résistivité transversale à 200 °C	2.9.1	50 000 M Ω · min.

lire:

Résistivité transversale après chaleur humide, mesure effectuée dans la chambre climatique (facultatif)	2.3	10 000 M Ω m min.
Résistivité transversale après chaleur humide et reprise	2.3	50 000 M Ω m min.
Résistivité transversale à 200 °C	2.9.1	50 000 M Ω m min.

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/60249-2-17-1992>

Page 11

Subclause 5, table 1

Instead of:

Volume resistivity after damp heat while in the humidity chamber (optional)	2.3	10 000 M Ω · min.
Volume resistivity after damp heat and recovery	2.3	50 000 M Ω · min.
Volume resistivity at 200 °C	2.9.1	50 000 M Ω · min.

read:

Volume resistivity after damp heat while in the humidity chamber (optional)	2.3	10 000 M Ω m min.
Volume resistivity after damp heat and recovery	2.3	50 000 M Ω m min.
Volume resistivity at 200 °C	2.9.1	50 000 M Ω m min.